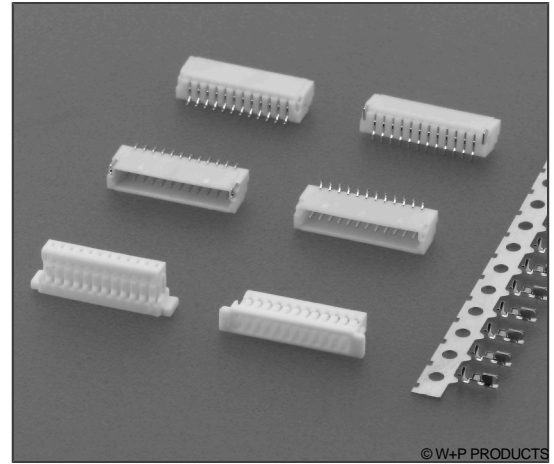


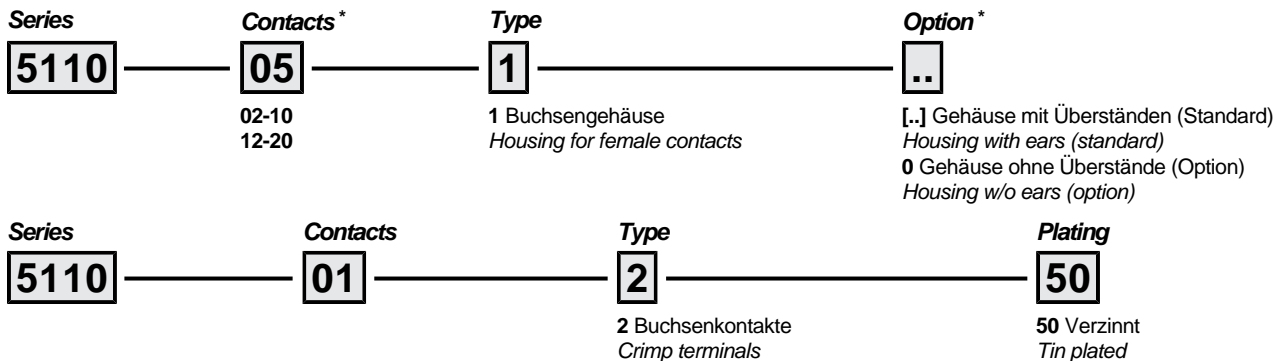
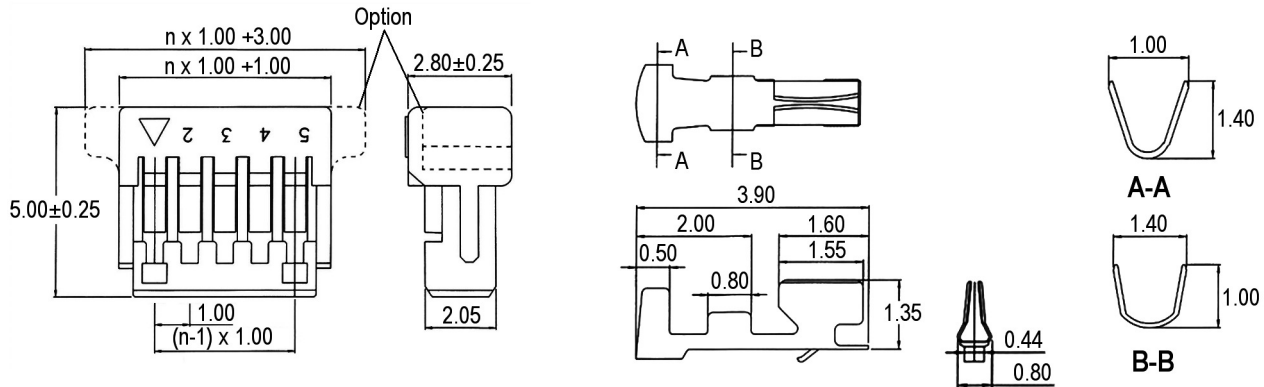
SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,00mm, stehend/liegend SMT Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.00mm Pitch, Vertical/Horizontal

Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	AWG 32 ~ 28
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 100 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	50 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +105 °C (Gehäuse -25 °C ... +85 °C) -40 °C ... +105 °C (Housings -25 °C ... +85 °C)
Verarbeitung <i>Processing</i>	Reflow-Lötverfahren <i>Reflow soldering</i>

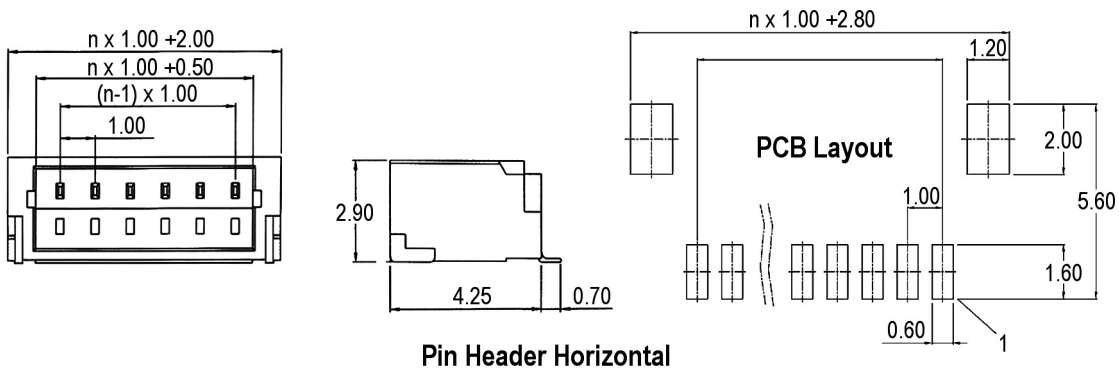
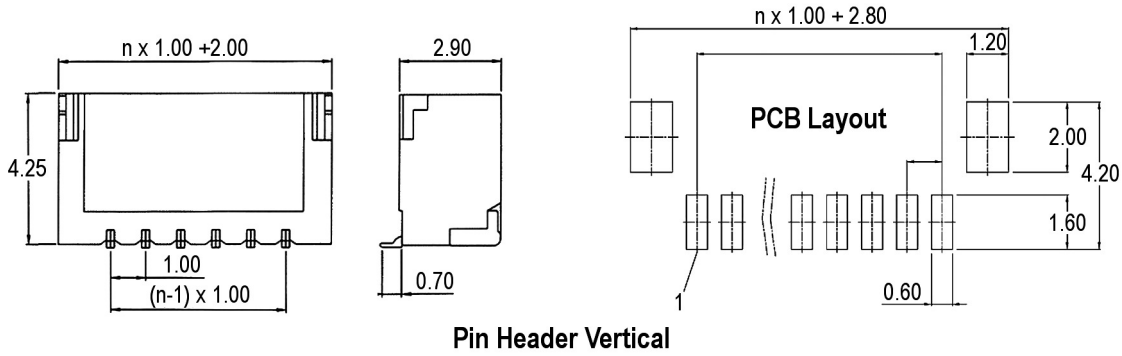


© W+P PRODUCTS



5110

SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,00mm, stehend/liegend
 SMT Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.00mm Pitch, Vertical/Horizontal



Series	Contacts*	Type*	Plating	Packaging*
5110	08 02-10 12-20	3 3 Stiftleiste stehend Vertical pin header 4 Stiftleiste liegend Horizontal pin header	50 50 Verzinkt Tin plated	ST ST TR (Option) PPTR (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:
ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
TR (Option) Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packaging
PPTR (Option) Tape & Reel mit P&P-Pads / Tape & Reel with P&P-Pads

Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150 °C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150 °C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature T_L	217 °C
Duration above T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature T_P	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	max. 8min

